

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

### 中芯國際積體電路製造有限公司\*

(于開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0981)

#### 中芯截至二零零七年六月三十日止三個月業績公佈

- 國際主要半導體代工製造商中芯國際積體電路製造有限公司（紐約交易所：SMI；香港聯交所：981）（「中芯」或「本公司」）於今日公佈截至二零零七年六月三十日止三個月的綜合經營業績。銷售額與二零零六年第二季度相比增加 3.7% 至 374,800,000 元，但與二零零七年第一季的 388,300,000 元相比下降了 3.5%。二零零七年第二季度的毛利率為 10.3%，二零零七年第一季度的毛利率為 9.5%。二零零七年第二季度為淨虧損 2,100,000 元，二零零七年第一季度為淨收入 8,800,000 元。每股美國預托股股份（攤薄）淨虧損為 0.0056 元。二零零七年第二季 90 納米制程晶圓的銷售額占總晶圓銷售額的百分比由二零零七年第一季的 14.4% 上升至 22.0%。
- 以下為本公司於二零零七年七月二十六日就截至二零零七年六月三十日止三個月的未經審核業績在報章所作的公佈全文。
- 本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(1) 條規定的披露責任於二零零七年七月二十六日作出本公佈。

以下為本公司於二零零七年七月二十六日就截至二零零七年六月三十日止三個月的未經審核業績在報章所作的報章公佈全文。

所有貨幣數位主要以美元列賬，除非特別指明。

報告內的財務報表數額按美國公認會計原則厘定。

中國上海—二零零七年七月二十六日—國際主要半導體代工製造商中芯國際積體電路製造有限公司（紐約交易所：SMI；香港聯交所：981）（「中芯」或「本公司」）於今日公佈截至二零零七年六月三十日止三個月的綜合經營業績。

二零零七年第二季財務概要：

- 銷售額與二零零六年第二季度相比增加 3.7%至 374,800,000 元，但與二零零七年第一季的 388,300,000 元相比下降了 3.5%。
- 二零零七年第二季度的毛利率為 10.3%，二零零七年第一季度的毛利率為 9.5%。
- 二零零七年第二季度為淨虧損 2,100,000 元，二零零七年第一季度為淨收入 8,800,000 元。
- 每股美國預托股股份（攤薄）淨虧損為 0.0056 元。
- 二零零七年第二季 90 納米制程晶圓的銷售額占總晶圓銷售額的百分比由二零零七年第一季的 14.4%上升至 22.0%。

關於本季營運成果，中芯國際總執行長張汝京博士表示：“中芯國際在二零零七年第二季持續擴張代工業務。本公司的營收較去年有所上升，但較上一季度有所下降是由於 DRAM 市場價格壓力所致。”

由近期市場趨勢來看，手機應用產品之需求及多樣性均持續增加，而電源管理 IC 及消費性電子商品如個人多媒體播放機及 MP3 和 MPEG4 等均看到了強勁的晶片代工需求。

技術方面，我們 90 納米制程的營收比重從二零零七年第一季之 14%提升到第二季之 22%，而二零零六年第二季時該制程比重則不到 1%。同時 90 納米邏輯產品在通訊手機類的應用亦由二零零七年第一季之 10.0%成長至第二季之 15.3%。我們預期第三季總營收將有 2%~5%之成長，而來自 90 納米制程之營收亦將持續成長。

我們目前正在進行 8GB NAND flash 產品開發，並預期 2GB NAND flash 產品將於二零零七年下半年問市，這個里程碑呈現中芯國際在 NAND flash 晶片代工市場上的技術及製造能力，並成為市場供應商之一。

我們的技術進程均照計劃發展，同時在 65 納米技術上有良好的進展。我們預期將在年底試產 65 納米邏輯產品，同時 DRAM 產品亦預期進入低於 90 納米之制程。

我們持續致力於改善獲利，加速成長及在策略上尋找促進股東權益的機會。我們相信透過持續謹慎的為領導客戶群開發先進的技術將促使中芯國際在二零零七年下半年及二零零八年持續成長及改善獲利。

電話會議／網上業績公佈詳情

日期：二零零七年七月二十七日

時間：上海時間上午七時半

撥號及登入密碼：美國 1-617-597-5342 或香港 852-3002-1672（密碼：SMIC）。

二零零七年第二季業績公佈網上直播可於 [www.smics.com](http://www.smics.com) 網站「投資者關係」一欄收聽。中芯網站在網上廣播後為期十二個月提供網上廣播錄音版本連同本新聞發佈的軟拷貝。

關於中芯國際

中芯國際（紐約證券交易所：SMI，香港聯合交易所：0981）總部位於中國上海，是世界領先的積體電路晶片代工公司之一，也是中國內地規模最大技術最先進的積體電路代工企業。向

全世界客戶提供 0.35 微米到 90 納米及更先進工藝的晶片製造服務。公司在上海的旗艦廠營運三座 200 毫米晶片廠，在天津營運一座 200 毫米晶片廠，中芯國際在北京營運的 300 毫米旗艦廠為中國內地第一座正式營運的 300 毫米晶片廠，在成都還有一座封裝測試廠。中芯國際還在美國、義大利、日本提供客戶服務和設立銷售辦事處，同時在香港設立了代表處。此外，中芯國際受委託經營管理武漢新芯積體電路製造有限公司的一座 300 毫米晶片廠，以及成都成芯半導體製造有限公司的一座 200 毫米晶片廠。敬請訪問公司網站：<http://www.smics.com>

## 安全港聲明

（根據 1995 私人有價證券訴訟改革法案）

本次新聞發佈可能載有（除歷史資料外）依據 1995 美國私人有價證券訴訟改革法案的“安全港”條文所界定的「前瞻性陳述」。該等前瞻性陳述，包括有關我們對二零零七年第三季的營收和來自於 90 納米制程銷售額將持續增長的預期、對產品問市時間和研發產品量產時間的預期、65 納米制程產品進入試生產時間的預期、我們的 DRAM 產品開始轉移至 90 納米以下制程的時間的預期、中芯於二零零七年下半年及二零零八年增加與改善獲利能力的預期，及包括在隨後“資本開支概要”和“二零零七年第三季度指引”中的聲明乃根據中芯對未來事件的現行假設、期望及預測而作出。中芯使用「相信」、「預期」、「計劃」、「估計」、「預計」、「預測」及類似表述為該等前瞻性陳述之標識，儘管並非所有前瞻性陳述均包含上述字眼。該等前瞻性陳述乃反映中芯高級管理層根據最佳判斷作出的估計，存在重大已知及未知風險、不確定性，以及其他可能導致中芯實際業績、財政狀況或經營結果與前瞻性陳述所載資料存在重大差異的因素，包括（但不限於）與半導體行業周期及市場狀況有關的風險、激烈競爭、中芯客戶能否及時接收晶圓產品、能否及時引進新技術、中芯量產新產品的能力、半導體代工服務供求情況、行業產能過剩、設備、零件及原材料短缺、製造生產量供給及最終市場的金融局勢是否穩定。

投資者應考慮中芯呈交予美國證券交易委員會（「證交會」）的文件資料，包括其於二零零七年六月二十九日以 20-F 表格形式呈交予證交會的經修訂的年度報告，特別是「風險因素」及「有關財政狀況及經營業績的管理層討論及分析」兩個部份，以及其於二零零四年三月八日以 A-1 表格形式呈交予香港聯合交易所（「香港聯交所」）的登記聲明，以及中芯可能不時向證交會及香港聯交所呈交的該等其他文件，包括 6-K 表格。其他未知或不可預知的因素亦可能會對中芯日後的業績、表現或成就造成重大不利影響。鑒於上述風險、不確定性、假設及因素，本新聞發佈中提及的前瞻性事件可能不會發生。務請閣下注意，切勿過份依賴此等前瞻性陳述，此等陳述僅就本新聞發佈中所載述日期（或如無有關日期，則為本新聞發佈日期）的情況而表述。除法律有所規定以外，中芯概不就因新資料、未來事件或其他原因引起的任何情況承擔任何責任，亦不擬更新任何前瞻性陳述。

## 台積電法律訴訟之近期發展

二零零六年八月二十五日，台積電於美國加州阿拉米達郡高級法院，指稱本公司違反和解協定、違反本票約定及不當使用商業機密而對本公司及若干子公司（中芯上海、中芯北京及中芯美國）提出訴訟。台積電訴求（其中包括）損害賠償、禁制令、律師費及提前支付和解協定項下尚未支付之金額。

在目前的訴訟中，台積電指稱本公司將台積電之商業機密運用於製造本公司0.13微米或更小制程之產品。台積電進一步稱，由於本公司違約，台積電對本公司的專利授權隨之終止，而有關對於本公司較大工藝產品之不起訴承諾亦已失效。

本公司強烈否認所有不當使用之指控。此外，台積電尚未證明、亦未拿出任何證據證明本公司之任何不當使用行為。目前，該訴求仍為未經證明的指控，而為本公司所否認。法院亦未發現台積電之訴求為有效，亦未確定審判日期。

本公司於二零零六年九月十三日公佈，除提出強烈否認台積電在美國訴訟中提出的指控外，本公司已於二零零六年九月十二日在美國反訴台積電，就（其中包括）台積電違反合約及違反默示的誠信及公平交易的承諾，要求台積電作出損害賠償。

中華人民共和國北京市高級人民法院於二零零六年十一月十六日受理本公司及本公司的全資子公司中芯上海及中芯北京共同提起的針對台積電違反誠實信用原則、商業詆毀的不公平競爭行為的指控（「中國訴訟」）。在中國訴訟中，本公司尋求（其中包括）判令台積電停止侵權行為、公開向本公司道歉和賠償（包括台積電因其侵權行為所獲得的利潤）。

二零零七年三月，美國加州法院駁回台積電禁止本公司進行中國訴訟之申請，台積電就此已向加州上訴法院上訴。

根據美國財務會計準則第144號，本公司必須決定目前未決訴訟是否構成需要進一步分析台積電的專利授權是否已受損害之事件。我們相信，該法律訴訟現處於十分早期階段，我們仍在評估該訴訟是否屬於該類事件。本公司預期將會獲得進一步資料以協助我們做出決定。根據美國財務會計準則第144號進行之任何損害分析結果可能對本公司財務狀況及經營業績產生重大影響。

#### 投資者聯絡資料：

Theresa Teng  
電話：+86-21-5080-2000，內線：16278  
theresa\_teng@smics.com  
手機：+86-13641770892

Adam Weng  
電話：+86-21-5080-2000，內線：16275  
adam\_weng@smics.com  
手機：Mobile: +86-13564310303

Peter Yu  
電話：+86-21-5080-2000，內線：11319  
peter\_yu@smics.com  
手機：+86-13918940553

二零零七年第二季經營業績概要：

以千美元為單位（每股盈利和百分比除外）

附注：

	二零零七年 第二季	二零零七年 第一季	季度比較	二零零六年 第二季 <sup>(3)</sup>	年度比較
銷售收入	374,829	388,284	-3.5%	361,446	3.7%
銷售成本	336,339	351,345	-4.3%	318,116	5.7%
毛利	38,490	36,940	4.2%	43,330	-11.2%
經營開支	47,113	21,722	116.9%	50,624	-6.9%
經營收益（虧損）	(8,623)	15,218	-	(7,293)	18.2%
其他收入（支出），淨額	6,085	(12,187)	-	(10,007)	-
所得稅利益	1,621	5,964	-72.8%	18,892	-91.4%
稅後淨收入(支出)	(917)	8,995	-	1,591	-
少數股權	(137)	977	-	768	-
應占聯營公司虧損	(1,001)	(1,212)	-17.4%	(1,002)	-0.1%
普通股持有人應占收入(虧損)	(2,054)	8,760	-	1,356	-
毛利率	10.3%	9.5%		12.0%	
經營利潤率	-2.3%	3.9%		-2.0%	
每股普通股股份淨收入（虧損）—基本(1)	(0.0001)	0.0005		0.0001	
每股美國預托股股份淨收入（虧損）—基本	(0.0056)	0.0237		0.0001	
每股普通股股份淨收入（虧損）—攤薄(1)	(0.0001)	0.0005		0.0001	
每股美國預托股股份淨收入（虧損）—攤薄	(0.0056)	0.0234		0.0001	
付運晶圓（8吋等值） <sup>(2)</sup>	443,445	450,592	-1.6%	388,498	14.1%
產能使用率	88.9%	86.2%		93.5%	

(1) 基於二零零七年第二季加權平均普通股 18,477,000,000 股（基本）及 18,477,000,000 股（攤薄），二零零七年第一季 18,451,000,000 股（基本）及 18,705,000,000 股（攤薄），二零零六年第二季度 18,303,000,000 股（基本）及 18,729,000,000 股（攤薄）。

(2) 包括銅接連件

(3) 經重申

- 二零零七年第二季銷售額降至 374,800,000 元，較二零零七年第一季的 388,300,000 元錄得季度降幅 3.5%，並較二零零六年第二季度的 361,400,000 元錄得年度升幅 3.7%。此下降主要由於 DRAM 產品市場處於低迷時期。
- 銷售成本由二零零七年第一季的 351,300,000 元下降 4.3% 至二零零七年第二季的 336,300,000 元，主要由於產能使用率上升及折舊費用下降所致。

- 二零零七年第二季毛利增加至 38,500,000 元，較二零零七年第一季的 36,900,000 元錄得季度升幅 4.2%；較二零零六年第二季度的 43,300,000 元錄得年度降幅 11.2%。
- 毛利率從二零零七年第一季的 9.5% 上升至二零零七年第二季 10.3%，主要是由於產能使用率上升、折舊費用下降所致。
- 二零零七年第二季的總經營費用增加至 47,100,000 元，較二零零七年第一季的 21,700,000 元錄得季度升幅 116.9%，主要由於二零零七年第一季認列的機台銷售收入所致。排除銷售機台的影響，二零零七年第二季的總經營開支與二零零七年第一季相比下降 1.1%。
- 二零零七年第二季的研發費用增加至 23,200,000 元，較二零零七年第一季的 21,700,000 元錄得季度升幅 6.7% 主要與上海新建 12 英寸廠專案的成本相關。
- 一般行政費用由二零零七年第一季的 17,100,000 元下降至二零零七年第二季的 14,700,000 元，主要是由於來自於經營活動的匯兌收益所致。
- 二零零七年第二季的銷售及市場推廣相關費用上升至 4,200,000 元，較二零零七年第一季 3,900,000 元錄得季度升幅 8.8%。

## 1. 收入分析

銷售分析			
以應用分類	二零零七年 第二季度	二零零七年 第一季度	二零零六年 第二季度
電腦	25.2%	33.0%	30.6%
通訊	40.7%	41.3%	46.2%
消費	24.3%	18.3%	18.6%
其他	9.8%	7.4%	4.6%
以服務類別分類	二零零七年 第二季度	二零零七年 第一季度	二零零六年 第二季度
邏輯 <sup>(3)</sup>	61.8%	58.2%	66.6%
記憶	28.9%	34.7%	28.8%
管理服務	3.2%	3.2%	0.2%
光罩製造，探測及其它	6.1%	3.9%	4.4%
以客戶類別分類	二零零七年 第二季度	二零零七年 第一季度	二零零六年 第二季度
非廠房半導體公司	43.8%	47.1%	49.8%
集成裝置製造商	42.3%	43.2%	41.9%
系統公司及其它	13.9%	9.7%	8.3%
以地區分類	二零零七年 第二季度	二零零七年 第一季度	二零零六年 第二季度
北美洲	39.6%	40.6%	46.7%
亞太區（不包括日本）	29.1%	24.2%	20.9%
日本	8.9%	9.9%	4.9%
歐洲	22.4%	25.2%	27.5%
晶圓收入分析			
各技術占晶圓銷售額的百分比（僅包括邏輯、記憶及銅接連件）	二零零七年 第二季度	二零零七年 第一季度	二零零六年 第二季度
0.09 微米	22.0%	14.4%	0.9%
0.13 微米	33.0%	38.1%	46.6%
0.15 微米	1.2%	2.9%	4.7%
0.18 微米	30.8%	34.1%	38.0%
0.25 微米	0.7%	0.7%	2.0%
0.35 微米	12.3%	9.8%	7.8%
各邏輯技術占邏輯晶圓銷售額的百分比 <sup>(1)</sup>	二零零七年 第二季度	二零零七年 第一季度	二零零六年 第二季度
0.09 微米	15.3%	10.0%	0.2%
0.13 微米 <sup>(2)</sup>	19.0%	17.6%	22.3%
0.15 微米	1.9%	4.7%	7.2%
0.18 微米	43.6%	50.1%	55.8%
0.25 微米	0.9%	1.0%	2.5%
0.35 微米	19.3%	16.6%	12.0%

附注：

- (1) 不包括 0.13 微米銅接連件
- (2) 代表來自于全流程製造晶圓的銷售收入
- (3) 包括 0.13 微米銅接連件

• 產能：

廠/ (晶圓尺寸)	二零零七年 第二季度*	二零零七年 第一季度*
上海廠 (8 寸) <sup>(1)</sup>	94,000	98,000
北京廠 (12 寸) <sup>(2)</sup>	54,000	57,150
天津廠 (8 寸)	21,000	22,000
每月晶圓裝配總產能	169,000	177,150

附注：

\* 期終每月晶圓計 8 吋等值

- (1) 上海廠包括晶圓一廠、晶圓二廠、晶圓三廠。
- (2) 北京廠包括晶圓四廠、晶圓五廠、晶圓六廠。

- 截至二零零七年第二季度末，由於產品組合的改變，每月產能下降至 169,000 片 8 吋等值晶圓。

付運及使用率：

8 吋等值晶圓	二零零七年 第二季度	二零零七年 第一季度	二零零六年 第二季度
付運晶圓 (包括銅接連件)	443,445	450,592	388,498
產能使用率 <sup>(1)</sup>	88.9%	86.2%	93.5%

附注：

(1) 產能使用率按輸出晶圓總額除以估計產能計算

- 二零零七年第二季晶圓付運下降至 443,445 片 8 吋等值晶圓，較二零零七年第一季的 450,592 片 8 吋等值晶圓及二零零六年第二季度的 388,498 片 8 吋等值晶圓分別錄得季度降幅 1.6%及年度升幅 14.1%。



## 2. 詳細財務分析

### 毛利分析

以千美元計	二零零七年 第二季	二零零七年 第一季	季度比較	二零零六年 第二季	年度比較
銷售成本	336,339	351,345	-4.3%	318,116	5.7%
折舊	159,154	185,707	-14.3%	188,663	-15.6%
其他製造成本	168,408	157,279	7.1%	120,552	39.7%
遞延成本攤銷	5,886	5,886	-	5,886	-
股票報酬攤銷	2,891	2,473	16.9%	3,015	-4.1%
毛利	38,491	36,940	4.2%	43,330	-11.2%
毛利率	10.3%	9.5%	-	12.0%	-

- 銷售成本由二零零七年第一季 351,300,000 元下降 4.3%至二零零七年第二季的 336,300,000 元, 主要由於產能使用率上升及折舊費用下降所致。
- 二零零七年第二季毛利上升至 38,500,000 元, 與二零零七年第一季的 36,900,000 元相比錄得季度升幅 4.2%, 與二零零六年第二季度的 43,300,000 元相比錄得年度降幅 11.2%。
- 毛利率由二零零七年第一季的 9.5% 上升至二零零七年第二季的 10.3%, 主要是由於產能使用率上升、折舊費用下降所致。

### 經營開支分析

以千美元計	二零零七年 第二季	二零零七年 第一季	季度比較	二零零六年 第二季	年度比較
總經營開支	47,113	21,722	116.9%	50,624	-6.9%
研究及開發	23,194	21,733	6.7%	24,345	-4.7%
一般及行政	14,746	17,087	-13.7%	16,837	-12.4%
銷售及市場推廣	4,234	3,893	8.8%	3,918	8.1%
無形資產攤銷	6,213	6,229	-0.3%	6,040	2.9%
資產處置收入	(1,274)	(27,220)	-95.3%	(516)	146.9%

- 二零零七年第二季的總經營費用增加至 47,100,000 元, 較二零零七年第一季的 21,700,000 元錄得季度升幅 116.9%, 主要由於二零零七年第一季認列的機台銷售收入所致。排除銷售機台的影響, 二零零七年第二季的總經營開支與二零零七年第一季相比下降 1.1%。
- 二零零七年第二季的研發費用增加至 23,200,000 元, 較二零零七年第一季的 21,700,000 元錄得季度升幅 6.7% 主要與上海新建 12 英寸廠專案的成本相關。
- 一般行政費用由二零零七年第一季的 17,100,000 元下降至二零零七年第二季的 14,700,000 元, 主要是由於來自於經營活動的匯兌收益所致。

- 二零零七年第二季的銷售及市場推廣相關費用上升至 4,200,000 元，較二零零七年第一季 3,900,000 元錄得季度升幅 8.8%。

### 其他收入（支出）

以千美元計	二零零七年 第二季	二零零七年 第一季	季度比較	二零零六年 第二季	年度比較
其他收入（支出）	6,085	(12,187)	-	(10,007)	-
利息收入	2,679	1,972	35.9%	4,039	-33.7%
利息支出	3,343	(15,003)	-	(12,214)	-
其他，淨額	63	844	-92.5%	(1,832)	-

- 二零零七年第二季其他非經營性收益為 6,100,000 元，相較於二零零七年第一季度的虧損 12,200,000 元，主要是由於二零零七年第二季收到政府支付的有關 12 英寸晶圓廠產能擴張的利息補貼。

### 流動資金

以千美元計	二零零七年 第二季	二零零七年 第一季
現金及現金等價物	372,449	341,704
短期投資	73,080	79,830
應收賬款	300,379	288,027
存貨	237,966	237,619
其他	125,413	128,080
流動資產總計	1,109,287	1,075,260
應付賬款	483,925	237,135
短期借款	108,000	43,000
長期借款的即期部份	290,533	170,839
其他	124,086	138,758
流動負債總計	1,006,544	589,732
現金比率	0.4x	0.6x
速動比率	0.7x	1.2x
流動比率	1.1x	1.8x

- 應付帳款增加主要由於購買 12 英寸廠先進的機器設備。

## 資本結構

以千美元計	二零零七年 第二季	二零零七年 第一季
現金及現金等價物	372,449	341,704
短期投資	73,080	79,830
長期票據即期部分	29,242	29,493
長期票據	64,443	78,267
短期借款	108,000	43,000
長期借款的即期部份	290,533	170,839
長期借款	574,564	719,697
總借款	973,097	933,536
股東權益	3,027,635	3,022,697
總借款對權益比率	32.1%	30.9%

## 現金流量概要

以千美元計	二零零七年 第二季	二零零七年 第一季
經營活動所得現金淨額	151,803	180,684
投資活動所耗現金淨額	(145,605)	(176,288)
融資活動所用(所耗)現金淨額	24,593	(26,331)
現金變動淨額	30,745	(21,916)

## 資本開支概要

- 二零零七年第二季資本開支為 370,000,00 元。
- 計劃下的二零零七年資本開支總額將約為 720,000,000 元，並將基於市場情況來做調整。

## 二零零七年第三季指引

以下聲明為前瞻性陳述，此陳述基於目前的期望並涵蓋風險和不確定性，部分已于之前的安全港聲明中闡明。

- 銷售額與二零零七年第二季度相比預期增加 2%-5%。
- 折舊及攤銷預期約介於 190,000,000 元至 195,000,000 元之間。

- 資本開支預期約介於 150,000,000 元至 200,000,000 元之間。
- 經營開支相對銷售的百分比預期 15%左右。

#### 近期公佈

- Saifun 收購中芯國際 90 納米生產工藝產權與技術 [2007-07-02]
- 2007 年 5 月 23 日舉行之股東周年大會投票表決結果 [2007-05-25]
- 中芯國際參加中美專案簽約儀式及中美高技術合作論壇 [2007-05-10]
- 股東周年大會通告 [2007-04-30]
- 中芯國際二零零七年第一季業績報告 [2007-04-27]

上述公佈詳情請參閱中芯網站。

[http://www.smics.com/website/enVersion/Press\\_Center/pressRelease.jsp](http://www.smics.com/website/enVersion/Press_Center/pressRelease.jsp)

### **Taylor Rafferty Associates, Inc. Investor Relations and Financial Communications**

#### **Hong Kong**

Ruby Yim  
Managing Director  
ruby.yim@taylor-rafferty.com

David Dambro  
Director  
david.dambro@taylor-rafferty.com  
+852 3196 3712

#### **New York**

Dana Johnston  
Director  
dana.johnston@taylor-rafferty.com  
+212 889 4350

## 合并資產負債表 (美元)

截至以下日期止

	二零零七年六月三十日 (未經審核)	二零零七年三月三十一日 (未經審核)
<b>資產</b>		
流動資產：		
現金及現金等價物	372,449,095	341,703,889
短期投資	73,079,577	79,829,802
應收賬款，已扣除撥備（二零零七年六月三十日為4,688,098元，二零零七年三月三十一日為3,924,775元）	300,379,234	288,026,530
存貨	237,966,018	237,619,469
預付款項及其它流動資產	13,059,060	17,161,431
出售機台和其他固定資產應收款項	109,907,931	110,136,499
待售資產	2,445,806	781,985
<b>流動資產合計</b>	<b>1,109,286,721</b>	<b>1,075,259,605</b>
土地使用權，淨額	47,139,822	38,005,628
廠房及設備，淨額	3,375,543,336	3,149,255,434
購入無形資產，淨額	62,413,712	65,866,883
遞延成本	82,410,154	88,296,594
股權投資	11,407,056	12,408,090
其他長期預付款	3,551,063	3,748,557
遞延稅資產	33,036,474	31,356,917
<b>資產合計</b>	<b>4,724,788,338</b>	<b>4,464,197,708</b>
<b>負債及股東權益</b>		
流動負債：		
應付帳款	483,925,496	237,134,879
預提費用及其它流動負債	94,683,683	109,059,238
短期借款	108,000,000	43,000,000
長期票據的即期部份	29,242,001	29,492,873
長期借款的即期部份	290,533,471	170,839,010
應付所得稅	159,421	206,071
<b>流動負債合計</b>	<b>1,006,544,072</b>	<b>589,732,071</b>
長期負債：		
長期票據	64,442,787	78,267,417
長期借款	574,563,677	719,697,029
與特許權協定相關的長期應付款	14,458,131	15,733,116
遞延稅負債	184,367	246,695
<b>長期負債合計</b>	<b>653,648,962</b>	<b>813,944,257</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,660,193,034</b>	<b>1,403,676,328</b>

少數股權	36,960,657	37,824,139
股東權益：		
普通股，面值 0.0004 元，法定股份為 50,000,000,000 股，截止二零零七年六月三十日 及二零零七年三月三十一日流通在外股份分別為 18,493,184,050 股及 18,470,356,166 股.	7,397,274	7,388,146
認股權證	32,387	32,387
額外繳入股本	3,302,244,424	3,295,215,798
累計其他綜合盈餘	64,874	111,027
累計虧絀	(282,104,312)	(280,050,117)
<b>所有股東權益合計</b>	<b>3,027,634,647</b>	<b>3,022,697,241</b>
<b>總負債及股東權益合計</b>	<b>4,724,788,338</b>	<b>4,464,197,708</b>

合并營運報表  
(美元)

	截至以下日期止三個月	
	二零零七年六月三十日 (未經審核)	二零零七年三月三十一日 (未經審核)
銷售額	374,829,258	388,284,436
銷售成本	336,338,574	351,344,670
<b>毛利</b>	<b>38,490,684</b>	<b>36,939,766</b>
經營費用：		
研究和開發	23,193,707	21,733,055
一般及行政	14,746,510	17,087,309
銷售和市場推廣	4,234,048	3,893,369
購入無形資產攤銷	6,213,171	6,228,616
來自廠房設備和其他固定資產的銷售所得	(1,274,018)	(27,220,665)
<b>經營費用總額</b>	<b>47,113,418</b>	<b>21,721,684</b>
<b>經營收益(虧損)</b>	<b>(8,622,734)</b>	<b>15,218,082</b>
其他收入(支出)：		
利息收入	2,678,460	1,971,672
利息支出	3,343,327	(15,003,379)
匯兌收益(虧損)	(1,514,169)	428,279
其他收入，淨額	1,577,151	416,621
<b>其他收入(支出)，淨額</b>	<b>6,084,769</b>	<b>(12,186,807)</b>
<b>稅前淨收入(虧損)</b>	<b>(2,537,965)</b>	<b>3,031,275</b>
所得稅利益	1,621,322	5,964,124
少數股權	(136,518)	976,527
股權投資虧損	(1,001,034)	(1,211,553)
<b>普通股持有人應占收入(虧損)淨額</b>	<b>(2,054,195)</b>	<b>8,760,373</b>
每股股份淨收入(虧損)，基本	(0.0001)	0.0005
每股美國預托股份淨收入(虧損)，基本	(0.0056)	0.0237
每股股份淨收入(虧損)，攤薄	(0.0001)	0.0005
每股美國預托股份淨收入(虧損)，攤薄	(0.0056)	0.0234
用作計算基本每股普通股收入(虧損) 淨額的股份(以百萬計)	18,477	18,451

用作計算攤薄每股普通股收入（虧損） 淨額的股份（以百萬計）	18,477	18,706
股權報酬乃關於：		
銷售成本	2,890,848	2,472,770
研究和開發	1,274,430	953,159
一般及行政	1,291,079	1,105,667
銷售和市場推廣	549,542	465,250



## 合并现金流量表 (美元)

截至以下日期止三個月  
二零零七年六月三十日      二零零七年三月三十一日  
(未經審核)                      (未經審核)

### 經營活動：

淨收入（虧損）	(2,054,195)	8,760,374
淨收入至經營活動所得（所耗）現金淨額對賬的調整：		
少數股權	136,518	(976,527)
處置廠房及設備收益	(2,469,694)	(27,220,665)
折舊及攤銷	175,187,932	173,370,422
購入無形資產攤銷	6,213,171	6,228,615
股票報酬攤銷	6,005,899	4,996,846
長期票據非現金利息費用	1,195,552	1,207,020
股權投資虧損	1,001,034	1,211,553
<b>營運資產及負債的變動：</b>		
應收賬款，淨額	(12,352,703)	(35,841,556)
存貨	(346,549)	37,559,483
預付款及其它流動資產	(52,120)	8,328,367
應付賬款	(4,132,746)	(6,657,095)
預提費用及其它流動負債	(14,740,560)	18,951,309
其他長期負債	-	(3,333,333)
應付所得稅	(46,650)	133,654
遞延稅資產	(1,679,557)	(6,070,017)
遞延稅負債	(62,328)	35,782
<b>經營活動所得現金淨額</b>	<b>151,803,004</b>	<b>180,684,232</b>

### 投資活動：

購入廠房及設備	(159,994,428)	(157,728,647)
處置廠房及設備所得款項	9,121,739	1,823,994
出售待售資產所得款項	2,501,868	3,963,708
		:
		:
		:
購買所獲無形資產	(3,984,011)	(2,468,200)
購買短期投資	(15,006,035)	(48,838,238)
出售短期投資	21,756,260	26,959,039
<b>投資活動所耗現金淨額</b>	<b>(145,604,607)</b>	<b>(176,288,344)</b>

### 融資活動：

短期借款所得款項	105,000,000	2,000,000
長期借款所得款項	-	168,165
償還長期票據支付的款項	(15,000,000)	-
償還長期借款支付的款項	(25,438,892)	-
償還短期借款支付的款項	(40,000,000)	(30,000,000)
行使雇員購股權所得款項	1,031,855	1,500,918

回購可贖回優先股	(1,000,000)	-
<b>融資活動所用(所耗)現金淨額</b>	<b>24,592,963</b>	<b>(26,330,917)</b>
匯率變動的影響	(46,154)	19,187
<b>現金及現金等價物增加(減少)淨額</b>	<b>30,745,206</b>	<b>(21,915,842)</b>
<b>現金及現金等價物—期間開始</b>	<b>341,703,889</b>	<b>363,619,731</b>
<b>現金及現金等價物—期間結束</b>	<b>372,449,095</b>	<b>341,703,889</b>

於本公佈刊發日期，本公司董事分別有董事會主席兼獨立非執行董事王陽元先生、本公司總裁、首席執行官兼執行董事張汝京先生、本公司非執行董事姚方先生、以及本公司獨立非執行董事徐大麟先生、川西剛先生、蕭崇河先生、陳立武先生、虞有澄先生及江上舟先生。

承董事會命

中芯國際積體電路製造有限公司

首席執行官

張汝京

中國上海，二零零七年七月二十六日

\* 僅供識別